

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-064087

(43)Date of publication of application : 29.02.2000

(51)Int.Cl.

C25D 5/34
C25D 7/12
H01L 21/288

(21)Application number : 10-230880

(71)Applicant : DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD

(22)Date of filing : 17.08.1998

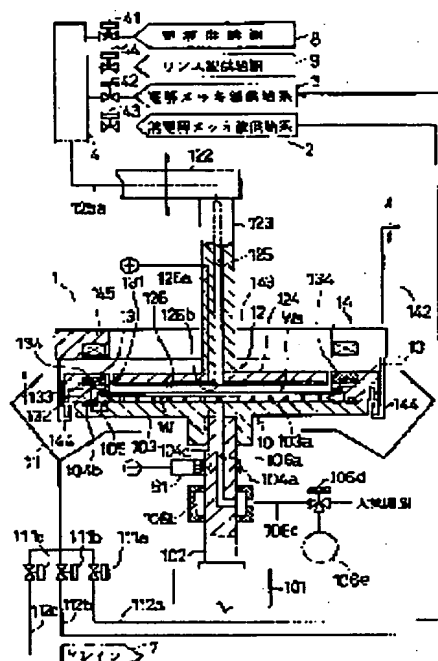
(72)Inventor : TSUJIMURA YUTAKA
MURAOKA YUSUKE

(54) SUBSTRATE PLATING AND SUBSTRATE PLATING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a substrate plating method and a substrate plating device high in practicality.

SOLUTION: By a control part, an electroless plating soln. is supplied from an electroless plating soln. feed line 2 to the surface Ws of a substrate W to be held by a substrate holding mechanism 10 to form a seed layer on the surface Ws of the substrate W by electroless plating. An electroplating soln. is then supplied by the control part from an electroplating soln. feed line 3 to the surface Ws of the substrate W on which the seed layer is formed and held by the mechanism 10, power is supplied between a first electrode 131 and a second electrode 126, and an electroplating layer is formed on the surface Ws of the substrate W in a specified thickness.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード [*] (参考)	
C 2 5 D	5/34	C 2 5 D	5/34	4 K 0 2 4
	7/12		7/12	4 M 1 0 4
H 0 1 L	21/288	H 0 1 L	21/288	E

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 14 頁)

(21) 出願番号 特願平10-230880

(22) 出願日 平成10年8月17日 (1998.8.17)

(71) 出願人 000207551

大日本スクリーン製造株式会社

京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の1

(72) 発明者 辻村 豊

京都府京都市伏見区羽東師古川町322 大日本スクリーン製造株式会社洛西事業所内

(72) 発明者 村岡 祐介

滋賀県野洲郡野洲町大字三上字ロノ川原2426番1 大日本スクリーン製造株式会社野洲事業所内

(74) 代理人 100093056

弁理士 杉谷 勉

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 基板メッキ方法及び基板メッキ装置

(57) 【要約】

【課題】 実用性の高い基板メッキ方法及び基板メッキ装置を提供する。

【解決手段】 制御部は、基板保持機構10に保持された基板Wの処理面Wsに、無電解メッキ液供給系2から無電解メッキ液を供給して基板Wの処理面Wsに無電解メッキでシード層を形成する。基板Wが基板保持機構10に保持された状態で、制御部は、次に、シード層が形成された基板Wの処理面Wsに電解メッキ液供給系3から電解メッキ液を供給するとともに、第1電極131と第2電極126との間に給電して、基板Wの処理面Wsに電解メッキで所定の厚さのメッキ層を形成する。

